

DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL "MATILDE HIDALGO"
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL E IDENTIDAD CULTURAL

Oficio Circular N° 047-DASMH-DESIC-2021
Loja, 19 de octubre de 2021

Asunto: INVITACIÓN A PARTICIPAR DEL PROYECTO "APOYO TECNOLÓGICO A JOVENES INNOVADORES DE LA PROVINCIA DE LOJA".

Señor (a)
RECTOR (A) DE LA UNIDAD EDUCATIVA
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Es propicia la oportunidad para extenderle un cordial saludo y augurarle éxitos en sus funciones y desearle bienestar familiar.

Por el presente nos permitimos dar a conocer que la Prefectura de Loja en convenio con el Ministerio de Educación, impulsa el proyecto "Apoyo tecnológico a jóvenes innovadores de la Provincia de Loja", el mismo que tiene como finalidad incentivar mediante la entrega de una tablet a estudiantes de tercer año de bachillerato de las unidades educativas, período académico 2021-2022 régimen costa que se hayan destacado en los ámbitos: académico, cultural, deportivo, liderazgo e innovación.

Para acceder a este incentivo, los establecimientos educativos deben registrarse en la página web de la institución: www.prefectura Loja.gob.ec, en el **Ítem Proyecto Tablet**, en donde podrán encontrar información como: parámetros del proyecto, requisitos para la inscripción y cronograma. El registro o inscripción lo realizarán desde el **25 al 28 de octubre del 2021**.

Notificada la unidad educativa con el número de cupos asignados, se procederá a la recepción de los documentos de acuerdo a los requisitos exigidos en los parámetros, en secretaría de la Dirección de Acción Social "Matilde Hidalgo" ubicada en Loja, calles Sucre y José Antonio Eguiguren esquina, segundo piso, desde el **11 al 19 de noviembre del 2021**.

Para mayor información comunicarse a los teléfonos: 2570234 ext. 8004

Con la seguridad de contar con su atención, reciba nuestro agradecimiento.

Atentamente,



Ing. Rafael Dávila Egúez
PREFECTO PROVINCIAL DE LOJA





Lic. María José Coronel Romero
VICEPREFECTA PROVINCIAL DE LOJA



Aprobado por:	Ab. Mayda Carrión C.	DASMH	
Revisado por:	Ing. Pablo Mendieta	DESIC	
Elaborado por:	Ing. Wilson Viñan	DESIC	